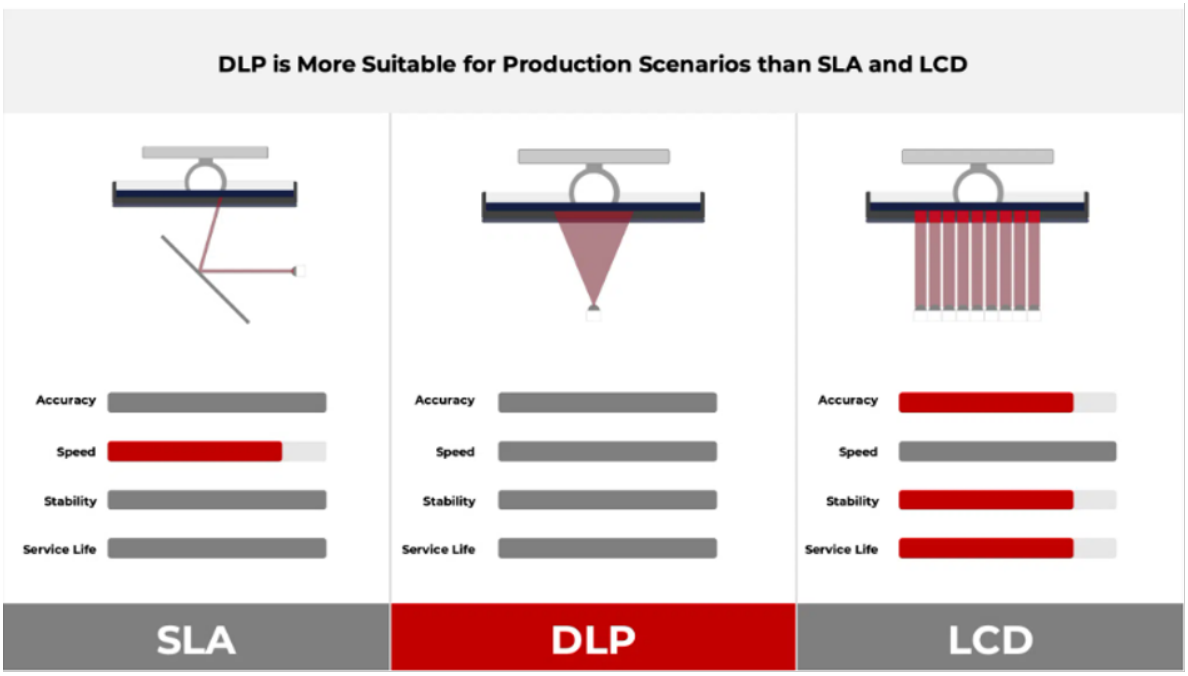
Raise3D, DF2 ile DLP 3D Baskı Çağını Başlatıyor

Raise3D'nin son yeniliği olan DF2 Digital Light Processing (DLP) çözümü ile 3D baskı teknolojisinde bir sıçrama tanıklık etti. Şirket, Frankfurt, Almanya'daki eski Orfeos Erben film evinin konforlu sinemasında, en son 3D yazıcısını, diğer teknolojik güncellemeleri ve geleceğe yönelik yol haritasını sundu.

DLP'nin SLA ve LCD yöntemlerine göre hız, hassasiyet ve çok yönlülük avantajlarını açıklayarak – Raise3D'nin DLP teknolojisine yaklaşımı, 3D baskıda bir paradigma değişikliğini temsil ediyor. DF2, dikkat çekici bir 200 x 112 x 300 mm yapı boyutu, hızlı baskı hızları ve eşsiz çözünürlük sunarak, çeşitli endüstrilerde yüksek kaliteli ve verimli üretim taleplerine yanıt veriyor. 25 mm/saat (0,1 mm tabaka başına) maksimum baskı hızına ve 2560 x 1440 XY çözünürlüğüne sahip DF2, diğer hiçbir DLP yazıcıda bulunmayan bir hassasiyet ve hız sunuyor.

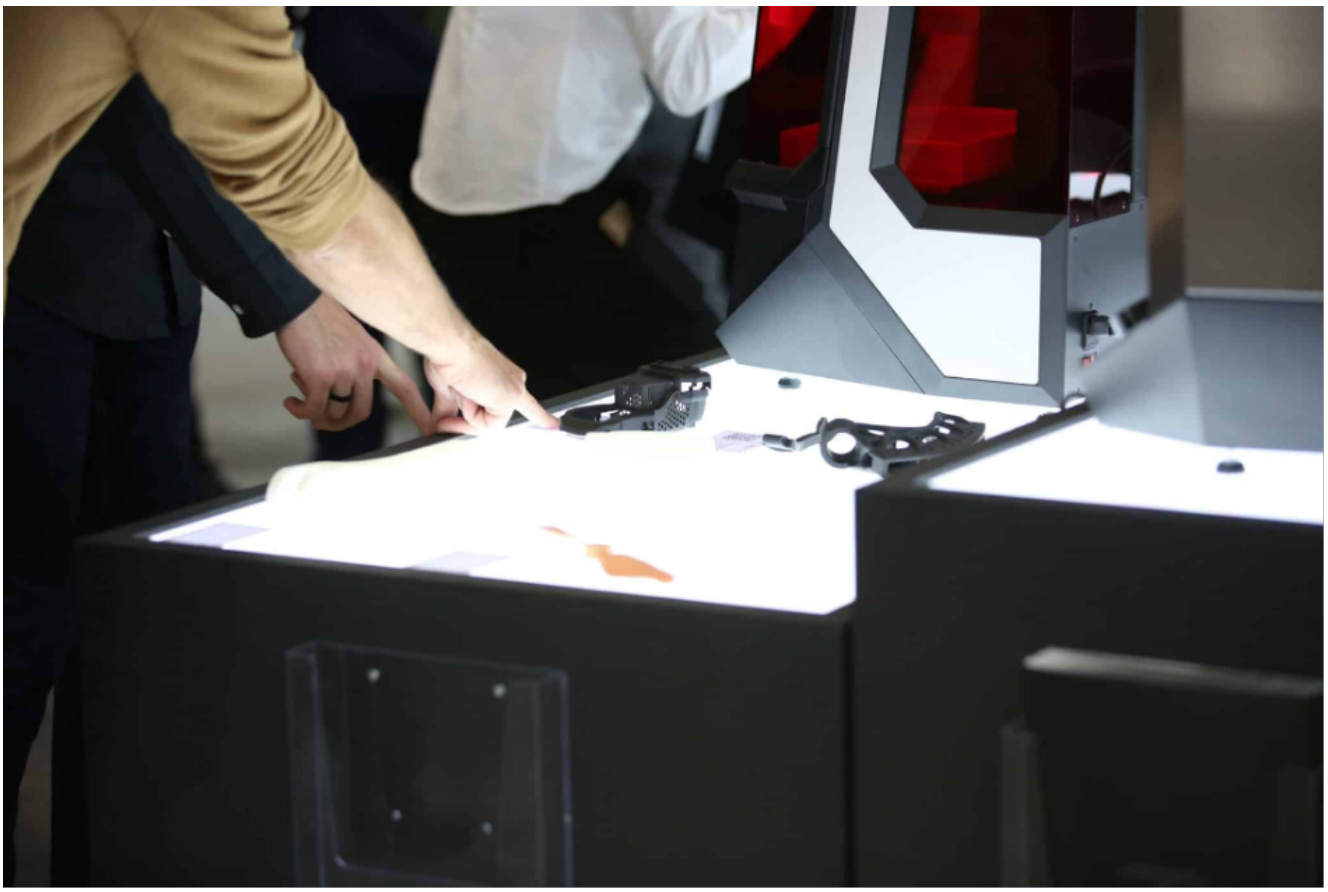


Bu yılki Formnext etkinliğinde, Raise3D DF2 çözümü ile DLP 3D baskının yeni bir çağını tanıttı.

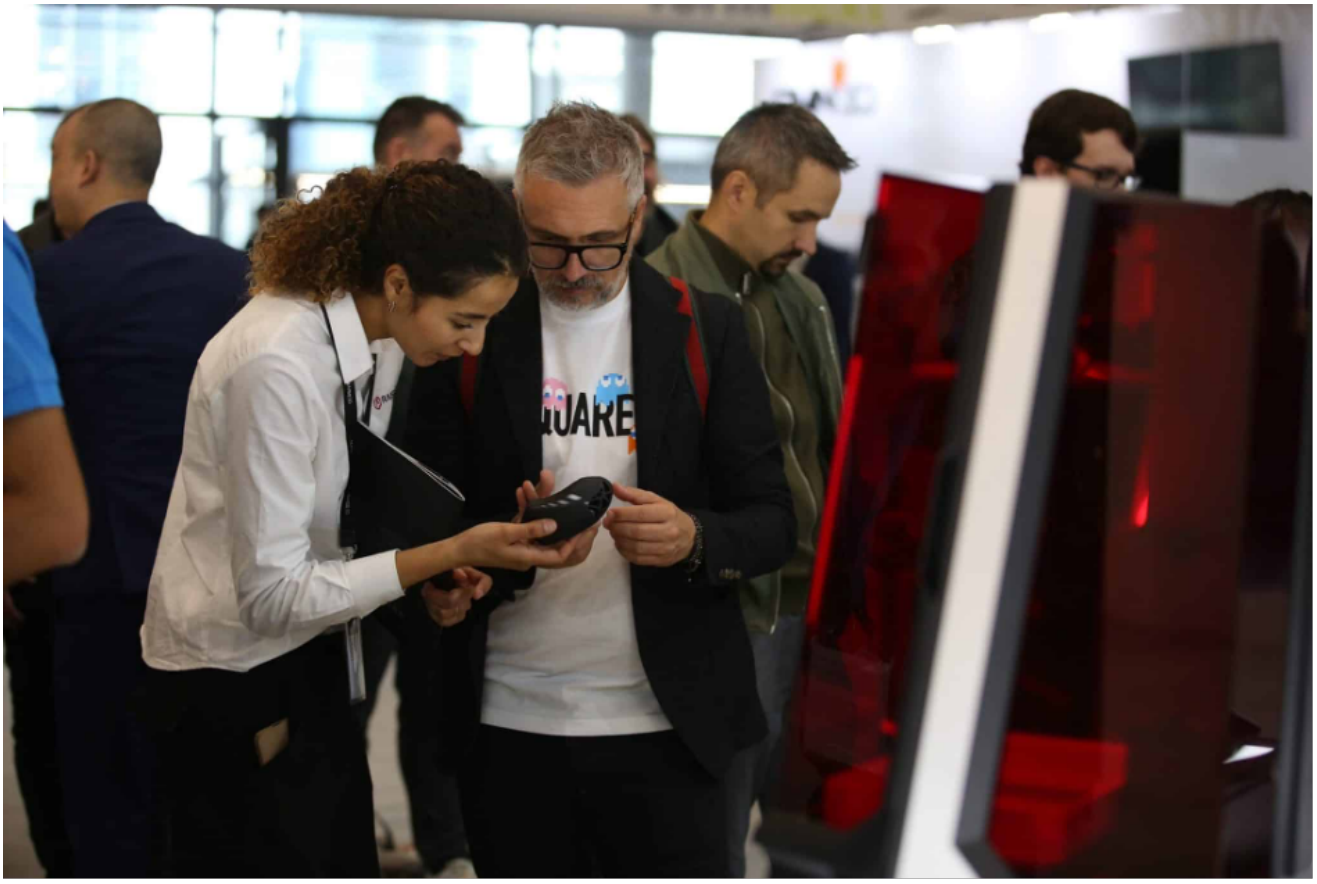
Yazıcının en dikkat çekici özelliklerinden biri, RFID teknolojisinin entegrasyonu sayesinde end-to-end iş akışıdır; bu, iş akışı parametrelerini otomatik olarak saklar ve yorumlar. Dilimleme ve planlamadan başlayarak, baskı, yıkama (DF Wash ile) ve iyileştirme (DF Cure ile) işlemlerine kadar – DF2 sistemi tüm süreci akıcı ve verimli bir şekilde sağlamak için entegre bir şekilde çalışır. Bu iş akışının entegrasyonu, günümüz hızlı üretim ortamlarında kritiktir.

DF2 çözümü, Raise3D'nin FFF teknolojisini genişletmek ve farklı kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla tasarlandı. Artitek ve Brucom Co. Ltd gibi mevcut müşteriler, DF2'nin yeteneklerini karmaşık tasarımlar ve küçük partili üretim için kullanabilirken, Shenzhen JLC Technology Group, DF2 teknolojisini zaten kullandığı FFF teknolojisi ile birleştirerek baskı çiftliği teklifini yükseltebilir ve ThyssenKrupp Bilstein, işbirliği robotları için donanımın özelleştirilmesinde kullanabilir.

Raise3D, DF2 için mevcut olan reçinelerin çeşitli uygulamalara hitap ettiğini belirtiyor – Standart Reçine ve direkt boyama ve kaplama için mat bir yüzeye sahip Yüksek Detaylı Reçine'den, dayanıklı ve darbeye dayanıklı Tough 2K Reçine'ye ve cam elyaf takviyeli termoplastiklerin sertliğini yansıtan ve ince duvarlı parçalar için ideal olan yüksek rijitlik ve üstün termal ve kimyasal dirence sahip Rigid 3K Reçine'ye kadar. Her reçine türü, belirli endüstri gereksinimlerini karşılamak üzere özenle geliştirilmiştir, detaylı prototiplerden dayanıklı, fonksiyonel parçalara kadar. Bu, Raise3D'nin BASF ve Henkel gibi üçüncü taraf reçine üreticileriyle olan ortaklıkları sayesinde mümkün olmuştur, bu ortakların markalı malzemeleri arasında LOCTITE 3D IND405, LOCTITE 3D PRO476, Ultracur3D RG 3280 ve Ultracur3D RG 1100 B bulunmaktadır.



DF2’nin anti-aliasing teknolojisi ve modelin kolayca ayrılmasını sağlayan hava soyulma teknolojisi gibi gelişmiş özellikleri de vurgulanmıştır. Bu özellikler, DF2’nin üretkenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek kalitede baskı ürünlerini garanti eder. Örneğin, Z-ekseninin stabilitesi, katmanlama veya merdiven katmanları olmadan Z-yönünde yüksek kaliteli baskılar sağlar.



Formnext’teki akşam etkinliği sadece bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda Raise3D’nin katma değerli imalatın geleceğine yönelik vizyonunun bir gösterisiydi. Gelişmiş DLP teknolojisi ile DF2 çözümü, endüstrilerin üretim ve prototipleme konularına yaklaşımını devrim niteliğinde değiştirmeye hazırlanıyor.